

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

公告编号：2025-001

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

（1）经杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现营业收入 48,687.34 万元左右，与上年同期相比，将增加 16,614.88 万元左右，同比增加 51.80%左右。

（2）预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-9,892.70 万元左右。

（3）归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-9,007.02 万元左右。

（4）预计 2024 年度实现 EBITDA（息税折旧摊销前利润）5,443.08 万元左右，与上年同期相比，将增加 3,642.75 万元左右，同比增加 202.34%左右。

（5）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

（一）营业收入：32,072.46 万元。

（二）利润总额：-10,676.43 万元。归属于母公司所有者的净利润：-8,445.09 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-7,515.99 万元。

（三）每股收益：-0.21 元/股。

(四) EBITDA (息税折旧摊销前利润) 1,800.33 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一) 公司 2024 年年度实现营业收入 48,687.34 万元左右,与上年同期相比,增加 16,614.88 万元左右,同比增加 51.80%左右。主要是:12 英寸超声波指纹识别芯片整套声学层开发完成并逐步量产,12 英寸图像传感器(CIS)整套光路层下半年开始实现量产,半导体声光学产品实现销售收入 7,892.60 万元左右,较上年增加 5,088.38 万元左右;射频滤波器芯片(Normal SAW、TC-SAW、TF-SAW)已实现量产,产出开始逐步爬坡,微纳电子产品实现销售收入 5,807.95 万元左右,较上年增加 4,960.31 万元左右;半导体封装逐步放量,包括射频滤波器芯片封装、超声波指纹识别芯片封装、功率器件芯片封装产出均有较大提升,半导体封测产品实现销售收入 6,737.32 万元左右,较上年增加 4,460.68 万元左右。

(二) 由于新工艺和新产品的认证周期较长,虽然部分项目开始逐步量产,但产能利用率仍处于爬坡阶段。公司投入的固定资产金额较大,导致折旧费用增加,2024 年折旧费 14,866.92 万元左右,较上年增加 3,662.00 万元左右。

(三) 随着项目逐步进入量产阶段,公司人工工资支出相应增加,2024 年人工支出 14,845.14 万元左右,较上年增加 4,009.00 万元左右。

(四) 公司持续加大新技术和新产品的研发投入,2024 年研发费用支出 10,758.34 万元左右,较上年增加 2,223.95 万元左右。

(五) 公司借款增加,相应利息费用增加,2024 年利息费用 2,662.49 万元左右,较上年增加 1,972.86 万元左右。

(六) 公司 2024 年实行股权激励计划,股份支付费用增加 515.54 万元左右。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2024 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日